

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2026-018

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于预计对子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
南京凌鸥创芯电子有限公司(以下简称“凌鸥创芯”)	5,000 万元	3,508.64 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	5,000 万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	3.97%
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 (以上均不适用)
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为满足日常经营需要，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“晶丰明源”）拟为全资子公司凌鸥创芯提供合计不超过人民币 5,000 万元的日常经营履约类担保额度。

相关担保具体情况以正式签署的合同文件为准。上述担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在前述有效期内，本次预计额度可在公司合并报表范围内各级子公司之间进行内部调剂。若在本次额度预计的授权期间发生新设立或收购子公司情况的，对该等子公司提供的担保亦可在上述额度内分配使用。

董事会授权董事长或其授权人士在上述担保范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由相关业务部门负责组织实施。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计对子公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议，经公司董事会审议通过后生效。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产的比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
晶丰明源	凌鸥创芯	100%	20.92%	3,508.64 万元	5,000 万元	3.97%	自董事会审议通过之日起 12 个月	否	否

（四）担保额度调剂情况

本次担保额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述有效期内，本次预计额度可在公司合并报表范围内各级子公司之间进行内部调剂。若在本次额度预计的授权期间发生新设立或收购子公司情况的，对该等子公司提供的担保亦可在上述额度内分配使用。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、南京凌鸥创芯电子有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	南京凌鸥创芯电子有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	晶丰明源 100%全资控股		
法定代表人	李鹏		
统一社会信用代码	91320192MA1MRM7K4X		
成立时间	2016-08-16		
注册地	南京经济技术开发区兴智路6号兴智科技园B栋第15层		
注册资本	289.5255万人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子元器件制造；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月 （未经审计）	2024年12月31日 /2024年度 （经审计）
	资产总额	27,377.07	29,291.69

	负债总额	5,727.79	6,240.15
	资产净额	21,649.29	23,051.55
	营业收入	26,918.50	29,844.91
	净利润	8,372.77	9,694.06

（二）被担保人失信情况

前述全资子公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司与无锡华润上华科技有限公司签订担保最高债权金额为人民币 1,200 万元的担保合同、与上海华虹宏力半导体制造有限公司签订担保最高债权金额为 300 万美元的担保函（按 2025 年 12 月 31 日汇率换算为人民币 2,108.64 万元）、与广东横琴芯联科技有限公司签订债务最大保证金额为 200 万元的担保合同，担保对象均为凌鸥创芯，担保内容为对凌鸥创芯产生的系列债权进行担保，上述担保余额未超过本次担保预计额度；担保合同所涉及的担保金额、期限、方式等内容均符合法律法规的相关要求。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项系为确保全资子公司生产经营工作持续、稳健开展需要，结合目前公司及全资子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的全资子公司，经营情况稳定，公司提供担保的风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于预计对子公司提供担保额度的议案》。

董事会认为：本次担保事项是为保证公司及子公司未来日常经营与业务顺利开展，符合公司的发展规划。公司及子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保总额为 5,000.00 万元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，且均为公司为合并报表范围内的全资及控股子公司提供的担保），分别占公司最近一期经审计总资产和归属于上市公司股东的净资产的 2.33%和 3.97%。公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。逾期担保累计金额为 0 元，涉及诉讼的担保金额为 0 元。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 14 日